

1. 有關本集團的進一步資料

註冊成立

本公司的前身公司江蘇芯德半導體科技有限公司於2020年9月11日於中國成立為有限責任公司。於2024年6月27日，本公司根據適用中國法律法規由有限責任公司改制為股份有限責任公司，並更名為江蘇芯德半導體科技股份有限公司。我們的註冊辦事處位於中國南京市浦口區浦口經濟開發區林春路8號。

我們已設立香港營業地點，地址為香港銅鑼灣勿地臣街1號時代廣場2座31樓，並於2025年10月24日根據公司條例第16部向香港公司註冊處處長註冊為非香港公司。達盟香港有限公司的葉嘉紅女士獲委任為本公司授權代表，以代表本公司於香港接收法律程序文件及通知。本公司於香港接收法律程序文件的地址即上文所載的香港主要營業地點。

由於本公司在中國成立，故我們須遵守相關中國法律法規。有關中國法律法規的相關方面以及公司章程的概要分別載於本文件「法規」及附錄五。

本公司的股本變動

除「歷史、發展及公司架構」所披露者外，本公司股本於緊接本文件日期前兩年內並無變動。

附屬公司的股本變動

我們的附屬公司載於會計師報告，請參閱「附錄一—會計師報告」。除「附錄一—會計師報告」所提及的附屬公司外，本公司概無其他附屬公司。除「歷史、發展及公司架構」所披露者外，附屬公司的註冊資本於緊接本文件日期前兩年內並無其他變動。

股東通過的決議案

於2025年10月13日舉行的股東特別大會上，股東通過下列決議案（其中包括）：

- (i) [編纂]每股面值人民幣1.00元的H股，並使該等H股在聯交所[編纂]；
- (ii) 根據[編纂]將予[編纂]的H股，並授予[編纂]的[編纂]（或其代表）不多於根據[編纂][編纂]的H股數目的[編纂]%；
- (iii) 待向中國證監會完成備案後，於[編纂]完成後，股東合共持有的[編纂]將按一兌一基準[編纂]為H股；
- (iv) 待[編纂]完成後，批准及採納公司章程，其將於[編纂]生效，並授權董事會根據相關監管機關的任何意見對公司章程進行必要的修訂；及
- (v) 批准董事會及董事會授權的人士處理有關（其中包括）H股於聯交所[編纂]及[編纂]的所有事宜。

重組

我們並無就[編纂]進行任何公司重組。有關本公司歷史及發展的詳情，請參閱「歷史、發展及公司架構」。

2. 有關我們業務的進一步資料

重大合約概要

在緊接本文件日期前兩年內，我們訂立了以下屬於或可能屬於重大的合約（並非於日常業務過程中訂立的合約）：

- (i) [編纂]。

附錄六

法定及一般資料

知識產權

商標

截至最後實際可行日期，本集團已註冊下列與我們的業務有關且屬重大或可能屬重大的知識產權：

商標	註冊地點	註冊編號	類別	屆滿日期
CAPiC	中國	70402212	40	2033年9月20日
CAPiC	中國	70095085	40	2033年8月27日
芯德	中國	70098973	40	2033年8月27日
XD-HPFO	中國	60091353	40	2032年5月6日
XD-HPFO	中國	60099046	42	2032年4月27日
XD-HPFO	中國	60085397	9	2032年5月6日
JSSISEMI	中國	59650278	40	2032年3月20日
	中國	59645130	40	2032年3月13日
JSSISEMI	中國	50824487	42	2031年8月6日
JSSISEMI	中國	50847303	9	2031年7月6日
	中國	50828235	42	2031年8月20日
	中國	50643245	9	2031年10月6日

域名

截至最後實際可行日期，我們已註冊或獲授權使用下列我們認為對我們的業務而言屬重大的域名：

域名	註冊擁有人	屆滿日期
jssisemi.com.cn	本公司	2033年1月27日
jssisemi.com	本公司	2032年9月28日
jssisemi.cn	本公司	2032年11月4日

版權

截至最後實際可行日期，本集團已註冊下列對我們的業務而言屬重大或可能屬重大的版權：

版權名稱	註冊地點	註冊編號	首次公佈日期
上崗考核管理系統	中國	2023SR0743250	2023年6月28日
WMS倉庫管理系統	中國	2023SR0421217	2023年3月30日
異常偵測與分類系統	中國	2022SR1341662	2022年9月2日
統計過程控制系統	中國	2021SR1591735	2021年10月29日
品質異常處理系統	中國	2021SR1553839	2021年10月25日
光罩掩膜版管理系統	中國	2021SR1532382	2021年10月20日
電子化保養系統	中國	2021SR1534638	2021年10月20日
設備自動化作業控制系統	中國	2021SR1342437	2021年9月8日
芯德設備程序管理系統	中國	2021SR0881304	2021年6月11日

附錄六

法定及一般資料

專利

截至最後實際可行日期，本集團已註冊下列對我們的業務而言屬重大或可能屬重大的專利：

專利	註冊地點	申請編號	擁有人	類型	申請日期
一種真空包裝機 的加熱條 收緊裝置.....	中國	CN202422227269.5	本公司	實用新型	2024年9月11日
一種通孔基板的 雙面封裝混合 芯片結構.....	中國	CN202422489687.1	本公司	實用新型	2024年10月15日
一種倒裝芯片 吸附裝置.....	中國	CN202422232500.X	本公司	實用新型	2024年9月12日
一種貼散熱蓋 的倒裝芯片 封裝結構.....	中國	CN202422356795.1	本公司	實用新型	2024年9月26日
一種集成電容與 PMIC芯片的 高密度堆疊 封裝結構 及封裝方法.....	中國	CN202510652690.7	本公司	發明專利	2025年5月21日
一種濾波器模組 的封裝結構 及其製造方法...	中國	CN202211122369.0	本公司	發明專利	2022年9月15日

附錄六

法定及一般資料

專利	註冊地點	申請編號	擁有人	類型	申請日期
一種自動定位片匣尺寸平臺裝置.....	中國	CN202422389076.X	本公司	實用新型	2024年9月29日
一種晶圓定位治具.....	中國	CN202420650159.7	本公司	實用新型	2024年4月01日
一種具有雙封裝體的半導體封裝結構.....	中國	CN202422721183.8	本公司	實用新型	2024年11月08日
一種電路控制芯片封裝結構...	中國	CN202422150192.6	本公司	實用新型	2024年9月02日
一種嵌入式晶片級球柵陣列鍵合工藝中避免分層的方法.....	中國	CN202510541161.X	本公司	發明專利	2025年4月28日
一種超窄間距PI層開口方法及半導體封裝結構.....	中國	CN202210549652.5	本公司	發明專利	2022年5月20日
一種測量晶圓工作臺與頂針帽高度的治具.....	中國	CN202422222993.9	本公司	實用新型	2024年9月10日

附錄六

法定及一般資料

專利	註冊地點	申請編號	擁有人	類型	申請日期
一種佈線圖紙 設計自動化 軟件系統 及設計方法.....	中國	CN202111663523.0	本公司	發明專利	2021年12月30日
一種全方位檢測 半導體封裝 產品的治具.....	中國	CN202421662953.X	本公司	實用新型	2024年7月12日
一種散熱蓋活動 料倉.....	中國	CN202421843754.9	本公司	實用新型	2024年7月31日
一種便攜式芯片 運輸提籃.....	中國	CN202421750611.3	本公司	實用新型	2024年7月23日
一種晶圓表面具有 再鈍化層的凸塊 高度測量方法...	中國	CN202211695534.1	本公司	發明專利	2022年12月28日
一種扇外型芯片 封裝結構.....	中國	CN202420814100.7	本公司	實用新型	2024年4月18日
一種芯片超薄 封裝載板 及芯片封裝 結構和芯片 封裝方法.....	中國	CN202210485627.5	本公司	發明專利	2022年5月06日

附錄六

法定及一般資料

專利	註冊地點	申請編號	擁有人	類型	申請日期
一種對貼片環固定膠膜的裝置.....	中國	CN202420650143.6	本公司	實用新型	2024年4月01日
一種改善溢膠的芯片結構及其裸露芯片封裝結構.....	中國	CN202420321053.2	本公司	實用新型	2024年2月20日
一種電鍍線導電塊自動夾緊裝置.....	中國	CN202421398686.X	本公司	實用新型	2024年6月19日
一種TCB多孔放置工具.....	中國	CN202421371175.9	本公司	實用新型	2024年6月17日
一種正面保護的晶圓級芯片封裝結構.....	中國	CN202420816705.X	本公司	實用新型	2024年4月18日
一種芯片封裝結構.	中國	CN202421242815.6	本公司	實用新型	2024年6月03日
一種電鍍機卡盤導向柱.....	中國	CN202420501114.3	本公司	實用新型	2024年3月15日
一種芯片疊層封裝結構.....	中國	CN202420494637.X	本公司	實用新型	2024年3月14日
一種芯片吸嘴及其組成的芯片焊接裝置...	中國	CN202420485417.0	本公司	實用新型	2024年3月13日

附錄六

法定及一般資料

專利	註冊地點	申請編號	擁有人	類型	申請日期
一種防摔料裝置 及其組成的 連線機.....	中國	CN202323367008.5	本公司	實用新型	2023年12月11日
一種焊線機台 快速冷卻裝置...	中國	CN202421058949.2	本公司	實用新型	2024年5月15日
一種提高倒裝 方形扁平 無引腳封裝 產品散熱性 的封裝結構.....	中國	CN202420002729.1	本公司	實用新型	2024年1月02日
一種防止晶粒 黏貼膠溢出的 鍍銀框架及 其組成的 封裝結構.....	中國	CN202420036907.2	本公司	實用新型	2024年1月08日
一種單顆芯片 產品載具定位 檢測裝置.....	中國	CN202421150985.1	本公司	實用新型	2024年5月24日
一種自動檢驗 彈夾裝置.....	中國	CN202420300156.0	本公司	實用新型	2024年2月19日
一種適用於底部 填充的加熱 平臺裝置.....	中國	CN202420188709.8	本公司	實用新型	2024年1月26日

附錄六

法定及一般資料

專利	註冊地點	申請編號	擁有人	類型	申請日期
一種超聲波掃描載具台及焦距快速確定方法...	中國	CN202211131176.1	本公司	發明專利	2022年9月16日
一種包含雙重佈線層的芯片堆疊結構.....	中國	CN202421054470.1	本公司	實用新型	2024年5月15日
一種實現MEMS芯片互聯的扇外型晶圓級封裝結構.....	中國	CN202421024469.4	本公司	實用新型	2024年5月11日
一種光刻版保護膜貼膜治具.....	中國	CN202420754611.4	本公司	實用新型	2024年4月12日
一種分選機防卡料裝置.....	中國	CN202323529869.9	本公司	實用新型	2023年12月25日
一種改善晶粒黏貼膜分層的環鍍銀框架.....	中國	CN202323529848.7	本公司	實用新型	2023年12月25日
一種濺射工藝穩定性評估方法.....	中國	CN202211696268.4	本公司	發明專利	2022年12月28日
一種UV膜劃膜裝置.....	中國	CN202420821820.6	本公司	實用新型	2024年4月19日

附錄六

法定及一般資料

專利	註冊地點	申請編號	擁有人	類型	申請日期
適用於等離子 清洗機的防電弧 產生裝置.....	中國	CN202420565134.7	本公司	實用新型	2024年3月22日
一種扇外型封裝 方法及扇外型 封裝結構.....	中國	CN202111358610.5	本公司	發明專利	2021年11月16日
一種倒裝機鋼 嘴頭的自動 清潔裝置.....	中國	CN202420050924.1	本公司	實用新型	2024年1月09日
一種能夠預防回流 偏移的回流機...	中國	CN202323575466.8	本公司	實用新型	2023年12月27日
一種快速識別 坐標託盤.....	中國	CN202420772165.X	本公司	實用新型	2024年4月15日
減薄倒裝產品厚度 的封裝結構.....	中國	CN202322628825.5	本公司	實用新型	2023年9月26日
一種晶圓切割 刀片.....	中國	CN202420501123.2	本公司	實用新型	2024年3月15日
一種掛鍍式電鍍機 清洗槽.....	中國	CN202420378456.0	本公司	實用新型	2024年2月29日
一種自適應多種 厚度塑封模具...	中國	CN202420334682.9	本公司	實用新型	2024年2月23日

附錄六

法定及一般資料

專利	註冊地點	申請編號	擁有人	類型	申請日期
一種提高FCBGA 封裝平整度的 散熱蓋及其組成 的封裝結構.....	中國	CN202323459970.1	本公司	實用新型	2023年12月19日
一種能夠提高 封裝平整度的 散熱蓋.....	中國	CN202323327111.7	本公司	實用新型	2023年12月07日
一種應用於超薄 芯片編帶的 撿取吸嘴連桿...	中國	CN202420019775.2	本公司	實用新型	2024年1月04日
一種具有散熱和 電磁屏蔽功能的 封裝結構及 封裝方法.....	中國	CN202411018538.5	本公司	發明專利	2024年7月29日
一種倒裝芯片 封裝結構 用框架及其 芯片封裝結構...	中國	CN202323499007.6	本公司	實用新型	2023年12月21日
一種超大尺寸的 散熱蓋及使用 散熱蓋的半導體 封裝結構.....	中國	CN202323393783.8	本公司	實用新型	2023年12月12日

附錄六

法定及一般資料

專利	註冊地點	申請編號	擁有人	類型	申請日期
一種垂直混裝 芯片封裝結構...	中國	CN202323494085.7	本公司	實用新型	2023年12月21日
一種含高中低 密度芯片的 封裝結構.....	中國	CN202323299000.X	本公司	實用新型	2023年12月04日
一種新型基板 真空墊塊.....	中國	CN202323171190.7	本公司	實用新型	2023年11月23日
具有電磁屏蔽 功能的封裝結構.	中國	CN202322979032.8	本公司	實用新型	2023年11月03日
一種新型測量 膠重量杯.....	中國	CN202323010782.0	本公司	實用新型	2023年11月08日
一種CVS分析儀 加液裝置.....	中國	CN202322933567.1	本公司	實用新型	2023年10月31日
一種應用於晶圓 清洗的過濾 裝置.....	中國	CN202322892332.2	本公司	實用新型	2023年10月26日
無基板高密度 封裝結構.....	中國	CN202322551223.4	本公司	實用新型	2023年9月19日
具有電磁屏蔽 結構的晶圓、 芯片以及半導體 封裝結構.....	中國	CN202322982058.8	本公司	實用新型	2023年11月03日

附錄六

法定及一般資料

專利	註冊地點	申請編號	擁有人	類型	申請日期
一種QFN產品 注塑機台自動 脫膜裝置.....	中國	CN202323272285.8	本公司	實用新型	2023年12月01日
一種讓注塑設備 粉末樹脂均勻 鋪撒的裝置.....	中國	CN202322933466.4	本公司	實用新型	2023年10月31日
一種適用於測試機 上測試板的 降溫裝置.....	中國	CN202322895174.6	本公司	實用新型	2023年10月27日
光電傳感器 封裝結構及 其製備方法.....	中國	CN202310716516.5	本公司	發明專利	2023年6月16日
一種可實現平邊晶圓 校準的五角 調整器裝置.....	中國	CN202322768471.4	本公司	實用新型	2023年10月16日
一種高銅柱堆疊 的面對面芯片 封裝結構.....	中國	CN202322982231.4	本公司	實用新型	2023年11月03日
一種倒裝芯片 背面重佈線 封裝結構.....	中國	CN202323025109.4	本公司	實用新型	2023年11月09日

附錄六

法定及一般資料

專利	註冊地點	申請編號	擁有人	類型	申請日期
一種自動卡控晶圓圖譜上缺陷芯片的方法.....	中國	CN202410268468.2	本公司	發明專利	2024年3月11日
一種芯片塑封模具及其二次塑封工藝方法.....	中國	CN202111372272.0	本公司	發明專利	2021年11月18日
一種雙靶材磁控濺射反應腔室...	中國	CN202322668547.6	本公司	實用新型	2023年9月28日
一種顯微鏡限位裝置.....	中國	CN202322599959.9	本公司	實用新型	2023年9月25日
一種電位滴定儀電極固定裝置...	中國	CN202322436459.3	本公司	實用新型	2023年9月08日
一種倒裝產品虛焊的檢測裝置.....	中國	CN202322245390.6	本公司	實用新型	2023年8月21日
一種激光打印設備託盤通用載具.....	中國	CN202322565333.6	本公司	實用新型	2023年9月21日
一種防晶圓甩飛的清洗腔.....	中國	CN202322418482.X	本公司	實用新型	2023年9月06日
多芯粒高密度封裝結構.....	中國	CN202322272707.5	本公司	實用新型	2023年8月23日
一種離型膜.....	中國	CN202321124902.7	本公司	實用新型	2023年5月09日

附錄六

法定及一般資料

專利	註冊地點	申請編號	擁有人	類型	申請日期
一種晶圓級超薄四邊 無引腳芯片封裝 方法及芯片 封裝結構.....	中國	CN202311528044.7	本公司	發明專利	2023年11月16日
適用於電鍍線 自動上下料的 自動分批裝置...	中國	CN202322211007.5	本公司	實用新型	2023年8月17日
一種基板烘烤 固定裝置.....	中國	CN202322047551.0	本公司	實用新型	2023年8月01日
一種可供劃片 設備快速檢測 刀架水管狀態 的裝置.....	中國	CN202321296802.2	本公司	實用新型	2023年5月26日
一種具有異質 膠材的晶圓級 扇外型封裝結構 及其封裝方法...	中國	CN202311316007.X	本公司	發明專利	2023年10月12日
一種矽襯底 氮化鎵晶圓 的切割方法.....	中國	CN202311294713.9	本公司	發明專利	2023年10月09日

附錄六

法定及一般資料

專利	註冊地點	申請編號	擁有人	類型	申請日期
一種晶圓中多種芯片的圖譜合併、分發方法及系統.....	中國	CN202311316332.6	本公司	發明專利	2023年10月12日
一種應用於可潤濕側翼產品的切割刀片.....	中國	CN202321530807.7	本公司	實用新型	2023年6月15日
管腳側面上錫框架產品的切割刀片.....	中國	CN202321131390.7	本公司	實用新型	2023年5月11日
一種多層高密度封裝中曝光對位的工藝方法.....	中國	CN202311009444.7	本公司	發明專利	2023年8月11日
一種吸片頭及適配的安装座、安装裝置.....	中國	CN202320994667.2	本公司	實用新型	2023年4月27日
一種晶圓固定載具	中國	CN202321268159.2	本公司	實用新型	2023年5月24日
一種沖切模具推桿防呆機構...	中國	CN202320994633.3	本公司	實用新型	2023年4月27日
一種異形散熱蓋及使用異形散熱蓋的半導體封裝結構.....	中國	CN202320881740.5	本公司	實用新型	2023年4月19日

附錄六

法定及一般資料

專利	註冊地點	申請編號	擁有人	類型	申請日期
自動光學檢測 墊塊寬度調節 裝置	中國	CN202320319353.2	本公司	實用新型	2023年2月24日
一種芯片保護 封裝結構	中國	CN202320326250.9	本公司	實用新型	2023年2月27日
一種減少對PCB板 熱傳導的QFN 封裝結構及 其製備方法	中國	CN202310432274.7	本公司	發明專利	2023年4月21日
適用於半導體 封裝的二維碼 讀取裝置	中國	CN202320921973.3	本公司	實用新型	2023年4月23日
一種減少溢料的 基板結構	中國	CN202320409274.0	本公司	實用新型	2023年3月02日
一種能夠優化 濾波器產品 覆膜效果的 封裝結構	中國	CN202320701933.8	本公司	實用新型	2023年4月03日
使用矽基支撐 結構的晶圓級 扇外型封裝結構 及其製備方法	中國	CN202310433234.4	本公司	發明專利	2023年4月21日

附錄六

法定及一般資料

專利	註冊地點	申請編號	擁有人	類型	申請日期
一種晶圓級封裝 的再處理方法...	中國	CN202310431692.4	本公司	發明專利	2023年4月21日
電鍍液自動 滴定裝置.....	中國	CN202223606117.3	本公司	實用新型	2022年12月31日
一種耐高壓倒裝 芯片的三明治型 封裝結構.....	中國	CN202320223721.3	本公司	實用新型	2023年2月15日
通用的倒裝機的 金屬吸嘴結構...	中國	CN202320859392.1	本公司	實用新型	2023年4月18日
一種自動識別 晶圓圖紙上 多餘錫球及 去除多餘錫球 的方法.....	中國	CN202310410906.X	本公司	發明專利	2023年4月18日
一種測試晶圓及 其測試系統.....	中國	CN202223520092.5	本公司	實用新型	2022年12月28日
芯片剝離負壓 加熱平臺.....	中國	CN202223600004.2	本公司	實用新型	2022年12月30日
芯片導電柱.....	中國	CN202223400104.0	本公司	實用新型	2022年12月16日
包覆型多金屬 導電凸塊結構...	中國	CN202221949012.5	本公司	實用新型	2022年7月26日
晶圓切割刀片.....	中國	CN202223111526.6	本公司	實用新型	2022年11月22日

附錄六

法定及一般資料

專利	註冊地點	申請編號	擁有人	類型	申請日期
電鍍機連接線 接頭.....	中國	CN202223197621.2	本公司	實用新型	2022年11月30日
一種阻斷式寬口 點膠閥.....	中國	CN202223112230.6	本公司	實用新型	2022年11月23日
濾波器模組的 封裝結構.....	中國	CN202222463835.3	本公司	實用新型	2022年9月15日
一種封裝後線 改善產品翹曲 的裝置.....	中國	CN202222513767.7	本公司	實用新型	2022年9月22日
一種封裝後線 回流防翹曲 真空吸附治具...	中國	CN202222583938.3	本公司	實用新型	2022年9月28日
晶圓倒片裝置.....	中國	CN202222848908.0	本公司	實用新型	2022年10月27日
全自動網板 清洗機.....	中國	CN202222446928.5	本公司	實用新型	2022年9月15日
半導體塑封模具的 模流平衡結構...	中國	CN202222479551.3	本公司	實用新型	2022年9月19日
一種封裝後線回流 防翹曲裝置.....	中國	CN202221986949.X	本公司	實用新型	2022年7月29日
自動調整產品位置的 防呆裝置.....	中國	CN202222656709.X	本公司	實用新型	2022年10月09日

附錄六

法定及一般資料

專利	註冊地點	申請編號	擁有人	類型	申請日期
集成電路芯片 封裝結構.....	中國	CN202222504241.2	本公司	實用新型	2022年9月21日
一種植球裝載 清潔裝置.....	中國	CN202222159352.4	本公司	實用新型	2022年8月16日
一種具有高密度 連接層的芯片 封裝方法及 其芯片封裝 結構.....	中國	CN202211179108.2	本公司	發明專利	2022年9月27日
倒裝芯片封裝 結構.....	中國	CN202222063451.2	本公司	實用新型	2022年8月05日
一種可實現防止 分層的多圈 凹槽框架及 其芯片封裝 結構.....	中國	CN202221011731.2	本公司	實用新型	2022年4月28日
一種抽檢防呆 裝置.....	中國	CN202221958896.0	本公司	實用新型	2022年7月27日
一種可防反料盒 夾取系.....	中國	CN202123287634.4	本公司	實用新型	2021年12月24日
一種背膠全自動 擦片設備.....	中國	CN202222197408.5	本公司	實用新型	2022年8月19日
全自動錫球焊劑 供料櫃.....	中國	CN202221613513.6	本公司	實用新型	2022年6月23日

附錄六

法定及一般資料

專利	註冊地點	申請編號	擁有人	類型	申請日期
一種晶圓刻號 打印輔助治具...	中國	CN202221950431.0	本公司	實用新型	2022年7月27日
一種增強結合力 的晶圓級芯片 封裝結構.....	中國	CN202221511859.5	本公司	實用新型	2022年6月16日
一種全自動 抽檢器.....	中國	CN202221524956.8	本公司	實用新型	2022年6月17日
一種防呆配件.....	中國	CN202221943994.7	本公司	實用新型	2022年7月26日
一種接觸感應式 貼片機墊塊結構.	中國	CN202221210823.3	本公司	實用新型	2022年5月18日
一種增加散熱提升 電磁屏蔽的芯片 封裝結構.....	中國	CN202221608099.X	本公司	實用新型	2022年6月24日
一種可減少跨線 增大打線空間 的封裝框架.....	中國	CN202221488597.5	本公司	實用新型	2022年6月14日
一種封裝基板 結構.....	中國	CN202221530359.6	本公司	實用新型	2022年6月17日
一種QFN封裝結構 的固定裝置.....	中國	CN202220386403.4	本公司	實用新型	2022年2月24日
芯片封裝結.....	中國	CN202222145491.1	本公司	實用新型	2022年8月16日

附錄六

法定及一般資料

專利	註冊地點	申請編號	擁有人	類型	申請日期
一種倒裝芯片 封裝結構.....	中國	CN202221235259.0	本公司	實用新型	2022年5月20日
半導體封裝結構...	中國	CN202222091385.X	本公司	實用新型	2022年8月10日
一種可實現次品 安全去除的 檢驗去次機構...	中國	CN202221016034.6	本公司	實用新型	2022年4月28日
一種提高凸塊 及再佈線層 均勻性的芯片 封裝結構.....	中國	CN202220876408.5	本公司	實用新型	2022年4月15日
一種包含實體 切割連筋的 引線框架.....	中國	CN202221013025.1	本公司	實用新型	2022年4月27日
一種無基島框架 的封裝結構.....	中國	CN202221004919.4	本公司	實用新型	2022年4月27日
一種防遺忘的 定位架及 包括定位架 的切割裝置.....	中國	CN202220677276.3	本公司	實用新型	2022年3月24日
一種晶圓級晶片 尺寸封裝檢驗 換卷貼標裝置...	中國	CN202220550611.3	本公司	實用新型	2022年3月14日
一種雙面封裝 結構.....	中國	CN202220300421.6	本公司	實用新型	2022年2月15日

附錄六

法定及一般資料

專利	註冊地點	申請編號	擁有人	類型	申請日期
一種晶圓級芯片封裝結構.....	中國	CN202220656365.X	本公司	實用新型	2022年3月24日
一種可實現過濾功能的膠板結構.....	中國	CN202123082033.X	本公司	實用新型	2021年12月09日
一種增加管腳間隙的引線框架.....	中國	CN202220474953.1	本公司	實用新型	2022年3月04日
一種多芯片濾波器封裝結構.....	中國	CN202123310071.6	本公司	實用新型	2021年12月27日
一種六麵包覆的扇外型芯片封裝結構.....	中國	CN202123440565.6	本公司	發明專利	2021年12月31日
一種基於轉接板的多芯片濾波器的封裝結構.....	中國	CN202123310060.8	本公司	實用新型	2021年12月27日
一種防止銅片濺射的芯片封裝結構.....	中國	CN202123391212.1	本公司	實用新型	2021年12月31日
自動供液氣液分離藥液回流系統.....	中國	CN202123218365.6	本公司	實用新型	2021年12月20日
一種半導體器件及測試系統.....	中國	CN202123125358.1	本公司	實用新型	2021年12月13日

附錄六

法定及一般資料

專利	註冊地點	申請編號	擁有人	類型	申請日期
一種半導體 封裝結構及 測試系統.....	中國	CN202123170489.1	本公司	實用新型	2021年12月13日
一種芯片塑封 模具	中國	CN202122843347.0	本公司	實用新型	2021年11月18日
半導體濕法 設備混合配比 集中供液系統...	中國	CN202122822174.4	本公司	實用新型	2021年11月17日
一種引線框架 結構	中國	CN202122866577.9	本公司	實用新型	2021年11月22日
一種帶有電磁 屏蔽的芯片 封裝結構.....	中國	CN202122586612.1	本公司	實用新型	2021年10月26日
一種高密度扇出 封裝結構.....	中國	CN202220326220.3	本公司	實用新型	2022年2月18日
一種扇出封裝 方法及扇出 封裝結構.....	中國	CN202111352295.5	本公司	實用新型	2021年11月16日
一種基於阻隔層 的多芯片濾波器 封裝結構.....	中國	CN202123314330.2	本公司	實用新型	2021年12月27日

附錄六

法定及一般資料

專利	註冊地點	申請編號	擁有人	類型	申請日期
晶圓塗膠熱板 傳送示教輔助 治具	中國	CN202122367486.0	本公司	實用新型	2021年9月28日

3. 有關董事及監事的進一步資料

董事及監事的合約及委聘函的詳情

我們已與董事及監事各自就以下事項(其中包括)訂立合約:(i)任期,及(ii)終止條款。除上述披露者外,董事或監事並無或不擬與本公司任估其他成員公司訂立任何服務合約(於一年內到期或可由相關僱主於一年內終止而無需支付賠償(法定賠償除外)的協議除外)。

董事、監事及高級管理層酬金

除本文件「董事、監事及高級管理層 – 董事、監事及高級管理層薪酬」一節所披露者外,概無董事及監事於截至2024年12月31日止三個年度各年及截至2025年6月30日止六個月自本公司收取其他酬金。

所收取代理費用或佣金

[編纂]將就[編纂]收取[編纂],詳述於「[編纂] – [編纂]及開支」。除與[編纂]有關外,本集團於緊接本文件日期前兩年內並無就本公司或本集團任何成員的任何資本或證券的發行或銷售向任何人士(包括下文「 – 其他資料 – 專家資格及同意」所述的董事、發起人及專家)授出任何佣金、折扣、經紀費用或其他特別條款。

於緊接本文件日期前兩年內,概無就任何認購、同意認購、促使認購或同意促使認購本公司任何股份或債權證而已支付或應支付任何佣金。

附錄六

法定及一般資料

董事權益披露

緊隨[編纂]完成後（假設[編纂]並無獲行使且並無計及根據[編纂]購股權計劃授予的任何購股權獲行使而將予[編纂]的任何股份），我們的董事概無於本公司或其任何相聯法團（定義見證券及期貨條例第XV部）的股份、相關股份及債權證中，擁有[編纂]在聯交所[編纂]後根據證券及期貨條例第XV部第7及8分部須知會本公司及聯交所的權益及／或淡倉（包括彼等根據證券及期貨條例的有關條文被當作或視為擁有的權益或淡倉），或根據證券及期貨條例第352條須登記於該條所述登記冊的權益及／或淡倉，或根據上市規則附錄C3所載上市發行人董事進行證券交易的標準守則須知會我們及聯交所的權益及／或淡倉。

姓名	職位	權益性質	截至最後實際可行日期 及緊接[編纂]完成前		緊隨[編纂]完成後 (假設[編纂]未獲行使且並無計及根據 [編纂]購股權計劃授予的任何購 股權獲行使而將予[編纂]的任何股份)		
			股份數目 及描述	佔本公司權益 概約百分比	股份數目 及描述	佔本公司權益 概約百分比 ⁽⁸⁾	佔[編纂] (視情況而定) 權益概約 百分比 ⁽⁸⁾
張國棟先生	董事會主席、 執行董事	實益擁有人 ⁽¹⁾ ； 於受控法團 的權益 ⁽⁴⁾⁽⁵⁾ ； 一致行動 人士 ⁽⁶⁾	239,240,000股 非上市股份	24.95%	[編纂]	[編纂]%	[編纂]%
潘明東先生	執行董事	實益擁有人 ⁽²⁾ ； 於受控法團 的權益 ⁽⁴⁾⁽⁵⁾ ； 一致行動 人士 ⁽⁶⁾	239,240,000股 非上市股份	24.95%	[編纂]	[編纂]%	[編纂]%
劉怡先生	執行董事	實益擁有人 ⁽³⁾ ； 於受控法團 的權益 ⁽⁴⁾⁽⁵⁾ ； 一致行動 人士 ⁽⁶⁾	239,240,000股 非上市股份	24.95%	[編纂]	[編纂]%	[編纂]%

附錄六

法定及一般資料

附註：

- (1) 截至最後實際可行日期，張國棟先生直接擁有本公司股權約5.38%的權益；
- (2) 截至最後實際可行日期，潘明東先生直接擁有本公司股權約3.01%的權益；
- (3) 截至最後實際可行日期，劉怡先生直接擁有本公司股權約1.04%的權益；
- (4) 截至最後實際可行日期，南京寧泰芯企業諮詢管理合夥企業（有限合夥）（「寧泰芯」）直接擁有本公司股權約9.49%的權益。根據規管南京寧泰的有限合夥企業協議，張國棟先生為南京寧泰的普通合夥人。作為南京寧泰的普通合夥人，張國棟先生被視為於南京寧泰擁有實際控制權，因而為南京寧泰的控制人。因此，張國棟先生就證券及期貨條例被視為於南京寧泰持有的該等股份中擁有權益；
- (5) 截至最後實際可行日期，寧波梅山保稅港區寧浦芯企業管理合夥企業（有限合夥）（「寧波梅山」）直接擁有本公司股權約6.02%的權益。根據規管寧波梅山的有限合夥企業協議，張國棟先生為寧波梅山的普通合夥人。作為寧波梅山的普通合夥人，張國棟先生被視為於寧波梅山擁有實際控制權，因而為寧波梅山的控制人。因此，張國棟先生就證券及期貨條例被視為於寧波梅山持有的該等股份中擁有權益；
- (6) 根據張國棟先生、潘明東先生、劉怡先生、南京寧泰與寧波梅山訂立日期為2023年6月8日的一致行動人士協議，各方確認(i)彼等應就本公司業務營運及企業管治的決策而相互諮詢並在本公司股東大會或董事會會議上表決前達成共識後一致投票，及(ii)當各方未能達成一致時，各方應遵守張國棟先生的指示。因此，張國棟先生、潘明東先生、劉怡先生、南京寧泰及寧波梅山持有本公司已發行股本合共約24.95%，並為一致行動人士。彼等亦被視為本公司的單一最大股東集團；及
- (7) 計算乃根據假設(i)[編纂]非上市股份將[編纂]為H股；(ii)[編纂]並無獲行使；及(iii)並無計及根據[編纂]購股權計劃授予的任何購股權獲行使而將予發行的任何股份；及(iv)緊隨[編纂]完成後的已發行股份總數將為[編纂]股股份。

除本文件「主要股東」所披露者外，緊隨[編纂]完成及將[編纂][編纂]為H股後，董事並不知悉任何其他人士將於股份或相關股份中擁有根據證券及期貨條例第XV部第2及3分部的條文須向本公司及聯交所披露的權益及／或淡倉，或直接或間接擁有附帶權利可於所有情況下於本公司或本公司任何其他成員公司的股東大會上投票的任何類別股本面值10%或以上的權益。

附錄六

法定及一般資料

主要股東權益披露

有關緊隨[編纂]完成後將於我們的股份或相關股份中擁有根據證券及期貨條例第XV部第2及3分部的條文須向我們及聯交所披露的權益或淡倉的人士的資料，請參閱「主要股東」一節。

主要股東於本公司非全資附屬公司的權益

我們的附屬公司	註冊資本	擁有10%或以上股權的一方 (本集團成員公司除外)	概約股權百分比
揚州芯粒	人民幣820百萬元	揚州龍投芯粒半導體 產業投資基金合夥 企業(有限合夥)	71.95%

就上文所載，董事並不知悉任何人士(董事或監事除外)將於緊隨[編纂]完成後直接或間接擁有附帶權利可於所有情況下於本集團任何其他成員公司的股東大會上投票的任何類別股本面值10%或以上的權益。

4. 其他資料

[編纂]購股權計劃

本公司已採納[編纂]購股權計劃，該計劃已於2025年10月13日獲股東批准。根據[編纂]購股權計劃，[編纂]前可向合資格參與者授出最多[編纂]份購股權，佔本公司緊接[編纂]前股本總額的[編纂]%。行使購股權後，本公司將以發行H股的方式結算，惟須符合上市規則的相關規定。以下為[編纂]購股權計劃的主要條款概要：

目的

[編纂]購股權計劃旨在進一步完善本公司長期的激勵機制，吸引和留住優秀人才，充分激勵董事、高級管理層、關鍵管理人員、核心技術或業務人員，有效協調股東、本公司及核心團隊的利益，並按照「貢獻與回報」的原則促進本公司的可持續發展。

合資格參與者

合資格參與[編纂]購股權計劃的人士(「參與者」)包括董事、高級及關鍵管理人員、核心技術及業務人員，及曾為或預期將對本公司的成長發展作出重大貢獻的其他僱員，以及董事會認為有必要納入[編纂]購股權計劃的其他僱員。[編纂]購股權計劃共有38名參與者參與。

管理

[編纂]購股權計劃的批准、變更或終止均須股東大會通過，我們的董事會獲授權實施[編纂]購股權計劃。

行使價

購股權的行使價為人民幣[編纂]元，不低於本公司截至2024年12月31日的經審核每股資產淨值。倘發生資本化發行、紅股發行、分拆、合併、供股、股息分派等情況，行使價將進行調整。

歸屬及行使期

[編纂]購股權計劃自授予登記日期起60個月內有效，直至所有已授出購股權獲行使或註銷。未行使購股權將於行使期屆滿後自動失效。

根據[編纂]購股權計劃授出的購股權自授出日期起計有24個月的禁售期，可分三期行使。具體而言，30%的購股權將於授予登記後第24個月至第36個月可行使；40%購股權於第36個月至第48個月可行使；餘下30%購股權將於授予登記後第48個月至第60個月可行使。

失效

倘參與者辭任、解僱、退任、不稱職或違反相關責任，則授予該參與者但尚未行使的所有獎勵應立即停止行使，並由本公司註銷。

授予購股權詳情

於最後實際可行日期，[編纂]前可根據計劃向38名參與者授出合共[編纂]份購股權，佔緊接[編纂]前本公司已發行股本總額的[編纂]%。

附錄六

法定及一般資料

根據購股權計劃於[編纂]前將予授出的[編纂]購股權詳情載列如下：

姓名	地址	每股行使價 (人民幣元)	尚未行使 購股權涉及的 股份數目	佔緊隨[編纂] 完成後 已發行股份 概約百分比
高級管理層				
方亞萍女士.....	中國江蘇省江陰市石山路龍禧花園66 號樓102室	[編纂]	[編纂]	[編纂]%
小計			[編纂]	[編纂]%
其他核心管理層及 關鍵技術人員				
小計			[編纂]	[編纂]%
未行使購股權總數			[編纂]	[編纂]%

遺產稅

董事獲悉，根據中國法律，本公司或本集團任何其他成員公司不大可能須承擔重大遺產稅責任。

訴訟

截至最後實際可行日期，本集團任何成員公司概無涉及任何重大訴訟或仲裁，董事亦不知悉由或向本集團任何成員公司作出的任何待決或面臨的重大訴訟或申索。

獨家保薦人

獨家保薦人已代表我們向聯交所[編纂][編纂]批准本文件所提及將予[編纂]的所有[編纂][編纂]及[編纂]。獨家保薦人符合上市規則第3A.07條所載適用於保薦人的獨立性準則。

根據本公司與獨家保薦人訂立的委聘函，我們同意向獨家保薦人支付費用600,000.00美元，作為就建議於聯交所[編纂]擔任本公司的保薦人。

附錄六

法定及一般資料

合規顧問

本公司已遵守上市規則第3A.19條於[編纂]後委任華富建業企業融資有限公司為其合規顧問。

開辦開支

截至最後實際可行日期，本公司並無產生任何重大開辦開支。

發起人

本公司的發起人為心聯芯、南京元鈞及寧泰芯。有關本公司發起人的詳情，請參閱本文件「歷史、發展及公司架構」一節。

除[編纂]及本文件所披露者外，於緊接本文件日期前兩年內，概無就[編纂]及本文件所述的相關交易向上述名列的任何發起人支付、配發或給予或擬支付、配發或給予任何現金、證券、金額或其他利益。

專家資格

本文件所載或提述提供意見或建議的專家資格如下：

專家名稱	資格
華泰金融控股(香港)有限公司	根據證券及期貨條例可進行第1類(證券交易)、第2類(期貨合約交易)、第3類(槓桿式外匯交易)、第4類(就證券提供意見)、第6類(就機構融資提供意見)、第7類(提供自動化交易服務)及第9類(資產管理)根受規管活動(定義見證券及期貨條例)的持牌法團
安永會計師事務所 江蘇世紀同仁律師事務所	執業會計師兼註冊公眾利益實體核數師 本公司有關中國法律的法律顧問
弗若斯特沙利文(北京)諮詢有限公司 上海分公司	獨立行業顧問
安睿順德倫國際律師事務所	本公司有關國際制裁及出口管制法律的法律顧問

專家同意

本附錄「-4.其他資料 - 專家資格」一段所述專家已各自就本文件的刊發發出書面同意，同意按本文件所示格式及內容，轉載其報告及／或函件及引述其名稱，且並無撤回該等書面同意。

概無上文所名列專家於本公司任何成員公司擁有任何股權權益或權利（不論是否可強制執行）以認購或提名他人認購本公司任何成員公司的證券。

約束力

倘根據本文件提出申請，本文件即具效力，使全部有關人士須受公司（清盤及雜項條文）條例第44A及44B條的所有適用條文（罰則條文除外）所約束。

雙語文件

本文件的中英文版本根據香港法例第32L章《公司（豁免公司及招股章程遵從條文）公告》第4條規定的豁免分開刊發。

並無重大不利變動

董事確認，直至本文件日期，本集團的財務或貿易狀況或前景自2025年6月30日（即編製本集團最近期綜合財務報表的日期）起概無重大不利變動。

H股持有人的稅項

出售、購買及轉讓在香港股東名冊分冊中登記的H股均須繳納香港印花稅。就每名買方及賣方收取的現行費率為所出售或轉讓股份的對價或公平值（以較高者為準）的0.1%。有關稅項的進一步詳情，請參閱本文件附錄三。

其他事項

- (i) 除「歷史、發展及公司架構」所披露者外，於本文件日期前兩年內，概無發行或同意發行繳足或部分繳足的本公司或其任何附屬公司的股份或借貸資本以換取現金或現金以外代價；
- (ii) 概無本公司股份或借貸資本（如有）附有購股權或有條件或無條件同意附有購股權；
- (iii) 本公司或其任何附屬公司概無已發行或同意發行任何發起人、管理層或遞延股份；
- (iv) 本公司目前並無於任何證券交易所上市或於任何交易系統買賣；
- (v) 本公司並無任何發行在外的可換股債務證券或債權證；
- (vi) 除有關[編纂]外，本節「一 專家資格」所列專家概無於本集團任何成員公司的權利擁有實益或非實益權益或擁有權利或購股權（不論是否法律上可強制執行）以認購或提名他人認購本集團任何成員公司的證券；
- (vii) 本文件的中英文版本中，概以英文版本為準；
- (viii) 於本文件日期前12個月我們的業務並無出現可能對或已經對我們財務狀況構成重大影響的任何中斷情況；及
- (ix) 我們並無訂立放棄或同意放棄未來股息的安排。